

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年5月11日(2006.5.11)

【公開番号】特開2004-88093(P2004-88093A)

【公開日】平成16年3月18日(2004.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2004-011

【出願番号】特願2003-188290(P2003-188290)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K	3/46	B
H 05 K	3/46	N
H 05 K	3/46	S
H 05 K	3/46	T

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月17日(2006.3.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

工程P3pにおいては、押板19により加えられた圧力を除去して絶縁基板11aを冷却することにより、導体12aが埋設されると共に表面が平坦化された絶縁基板11aを得られる。結果、導体12aが埋設された絶縁基板11aの表面は所定の平面度Sを有すると共に、絶縁基板11aの受台18との当接表面に対して所定の平行度Pを有する。なお上述の押板19における平面度S'および平行度P'は、導体12aが埋設された絶縁基板11aの表面における平面度Sおよび平行度Pが次式(1)および(2)をそれぞれ満たすように選択される。

S < 10 μm . . . . (1)

P < 10 μm . . . . (2)

さらに好ましくは、S < 5 μm および P < 5 μm である。